

**HY400 Series** 导热界面材料  
Thermal Interface Material

专为电子零部件降温设计的导热界面材料  
Special Design for Electronic Components Heat Transfer






项目 Items	HY410	HY420	HY430	HY450	单位 Unit
颜色 Color	白色 White	白色 White	白色 White	白色 White	No
热传导系数 Thermal Conductivity	>1.42	>1.63	>1.84	>2.15	W/m-K
热阻抗 Thermal Impedance	<0.252	<0.249	<0.227	<0.125	°C-in <sup>2</sup> /W
比重 Specific Gravity	>2	>2	>2.1	>2.3	g/cm <sup>3</sup>
粘度 Viscosity	1000	1000	1000	1000	No
浓度 Thixotropic Index	380±10	350±10	320±10	300±10	1/10mm
瞬间耐温度 Moment Bore Temperature	-50~300°C	-50~340°C	-50~340°C	-50~340°C	°C
工作温度 Operation Temperature	-30~280°C	-30~300°C	-30~300°C	-30~300°C	°C

HY400

成份 Ingredients

矽化合物 Silicone Compounds	35%	35%	45%	55%	%
碳化合物 Carbon Compounds	45%	35%	25%	15%	%
氧化金属化合物 Metal Oxide Compounds	20%	30%	30%	30%	%
包装 Package	软管	迷你包	针管	罐装	吊卡
	ST	SP	TU	CN	Other
	20g~25g	0.5g~5g	0.5g~30g	30g~1000g	0.5g~5g

产品图片 Products Pictures

ST	SP	TU	CN	Other
				

※本产品耐温，不自燃，一般常温储存方式即可。

Thermal Interface Materials, Non-Spontaneous In room Temperature

以上数据由深圳市华能智研电子有限公司实验室测试所得，该实验室保留最终解释权。

All data above provide by Shenzhen Halnziye Electronics Co.,Ltd. Halnziye All Rights Reserved